证券代码：688220　　证券简称：翱捷科技

翱捷科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-1111

投资者关系活动类别	√特定对象调研　　□分析师会议 □媒体采访　　□业绩说明会 □新闻发布会　　□路演活动 □现场参观　　□电话会议 □其他
参与单位名称	（排名不分先后） 易方达、鹏华基金、中欧基金、兴全基金、富国基金、长江养老、景顺基金、广发基金、华泰资产、华泰保险、永赢基金、华夏基金、圆信永丰、金元顺安、人保基金、风和资本、博裕资本、浩成资管、摩根基金、华宝基金、招商基金、东吴基金、涌乐投资、勤辰资产、太平基金、财通基金、德邦基金、聚鸣投资、泰康资产、中泰电子、华泰电子、国海电子、国信证券、中信证券、兴业证券
时间	2026 年 11 月 2 日至 11 月 11 日
上市公司接待人员姓名	董事长、首席战略官　　戴保家 董事、董事会秘书、副总经理　　韩旻 董事、副总经理　　赵锡凯
投资者关系活动主要内容介绍	**问：公司 2026 年前三季度的整体经营情况如何？收入结构和盈利能力较上年同期有哪些变化？** 答：2026 年前三季度，公司继续围绕“自研芯片产品+芯片设计服务”双轮驱动战略推进经营业务。前三季度营业收入同比增长 32.43%。其中自有品牌产品作为核心基本盘，布局持续完善、下游终端应用日趋丰富，销售收入较上年同期增长约 23%；ASIC 定制业务持续深化与核心客户合作，订单承接能力增强，项目陆续交付，收入同比增长约 214%。受益于收入规模扩大、产品及业务结构优化、销售价格及产

	业链价格调整，前三季度综合毛利率 30.80%；叠加研发及其他费用优化、对外投资公允价值变动收益增加等因素，公司年初至报告期末实现利润总额 3.61 亿元，归母净利润 3.58 亿元，扣除非经常性损益后的净利润 8,494 万元，各项利润指标均较上年同期扭亏为盈。详细经营数据请参见公司已披露的 2026 年第三季度报告。 **问：公司研发费用长期趋势如何？随着后续产品开发和 ASIC 定制业务规模持续扩大，是否会导致研发费用同步增长？** 答：从长期看，公司将持续保持研发投入，保障自有产品迭代、前沿技术和底层平台能力储备。按照现阶段业务规划，未来几年的研发费用年平均增幅比例不大，预估在 15%以内。主要原因是公司前期平台型芯片的主体开发工作已落地，尤其是初代及二代平台型产品的大规模开发周期已基本完成；后续以迭代优化为主，研发投入节奏相对平稳可控。 ASIC 定制业务包含 NRE 定制开发、量产供货两个阶段。NRE 开发环节相关人员投入按会计政策归集为合同履约成本，项目验收后结转至营业成本，不计入研发费用；量产阶段以供应链及交付运营为主，新增研发投入较少。公司研发投入仅围绕支撑 ASIC 业务的共性底层技术、可复用 IP、前瞻性研发展开，ASIC 业务规模增长，不存在必然同步推高研发费用的情形，但不排除公司基于战略需要主动加大相关技术研发投入的可能。 **问：注意到公司 ASIC 定制业务在手订单第三季度增量主要是量产业务，这是新客户的纯量产业务还是交付的 NRE 订单的后续量产？是否还在持续新签 ASIC 订单？** 答：公司第三季度新增在手订单，既包含新签署的 ASIC

	项目 NRE 订单，也包含前期已经完成 NRE 交付验收项目对应的后续量产订单，其中增量以已交付 NRE 订单的后续量产订单为主，属于老客户项目落地后的量产跟进，并非新客户的纯量产业务。目前公司仍在持续洽谈并签署新的 ASIC 项目订单。在项目筛选层面，公司优先遴选行业头部或具备成长潜力的优质客户，聚焦应用前景良好、工艺先进、商业化落地能力较强的项目。 **问：ASIC 端侧 AI 新增订单是哪些类型客户？是否具备量产前景？** 答：现阶段公司端侧 AI 相关在手订单中，应用领域包括端侧 AI 算力终端、具身智能、机器人大脑、机器人小脑及可穿戴等。公司看好端侧 AI 长期发展机遇，在项目筛选环节综合评估商业化落地条件，优先承接量产可能性较高的项目订单。相关产品能否实现量产、其上量的节奏如何，受客户自身业务规划、下游市场需求、商业推广等多重因素影响，存在不确定性，请投资者注意风险。 **问：公司第三季度毛利率增长是 ASIC 业务带来的吗？后期是否能维持或继续提升？** 答：目前 ASIC 业务整体毛利率确实高于自有品牌产品，但因其第三季度收入占比不高，并非拉动公司整体毛利率提升的主要因素。本期毛利率增长，主要来源于自有产品结构优化、叠加销售价格提升及产业链价格调整等因素。短期毛利率受供需、原材料等因素影响可能会有波动；长期来看，如果对目前低毛利的产品迭代顺利、高毛利产品销售占比持续提升，毛利率存在进一步改善空间。 **问：公司 5G eMBB 业务的进展及明年展望如何？**

	答：截至第三季度末，公司基于 1901 平台的 5G eMBB 芯片累计出货量已超过 200 万颗，该产品已实现规模量产出货，充分验证了产品性能，标志着公司 5G eMBB 产品已具备较强市场竞争力。 从目前情况看，印尼客户受自身装机进度影响，提货规模阶段性回落。公司同步推进多个项目，若下游客户装机及项目推进顺利，明年 5G eMBB 出货量存在继续增长的空间。 **问：公司 4G 智能 SoC 市场推进情况怎么样？手机端什么时候放量？** 答：第一代 4G 八核智能 SoC 商业化拓展取得积极进展，手机端已实现多家白牌客户导入，同时在非手机终端持续拓展。综合现有项目进展情况，预计明年全年出货将突破千万颗，为公司贡献收入增量。但客户量产节奏、终端市场需求存在波动，放量进度仍存在不确定性，请投资者注意风险。 **问：下一代 5G 研发进展情况如何？** 答：第二代 5G 智能 SoC 预计本年度进行流片。第三代 5G 智能 SoC 正处于研发过程中。具体情况请以公司后续公开披露信息为准。 **问：公司 H 股发行的进度如何？** 答：公司 H 股发行上市相关筹备工作有序开展，本次发行尚需完成中国证监会境外发行备案以及香港联交所审核等流程，审核周期、发行窗口受多重因素影响，存在不确定性。公司将严格履行信息披露义务，相关进展请以公司正式公告为准。 **备注：需特别说明的是，本次交流活动问答回复中，所有关于未来业务发展的预期，因预测周期距当前时点尚有一定时间跨度，政策环境、市场情况、项目**

	进度等客观因素可能存在动态变化，具体数据以当年审计数字为准；另外，当前盈利水平受下游需求、行业周期、供应链价格波动等因素影响，后续存在波动风险，请投资者注意投资风险。
附件清单 （如有）	无